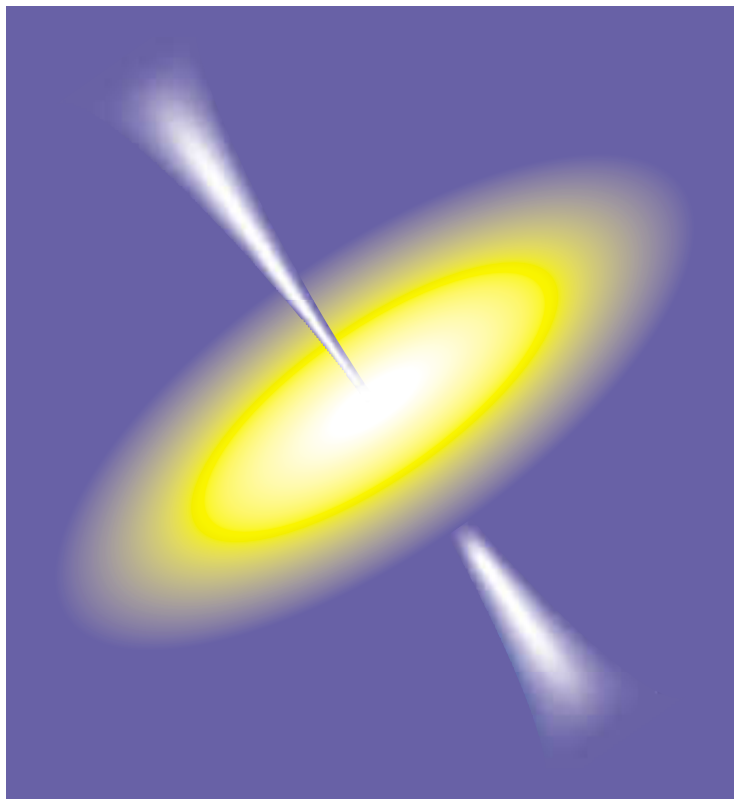


第 78 期

中間事業報告書

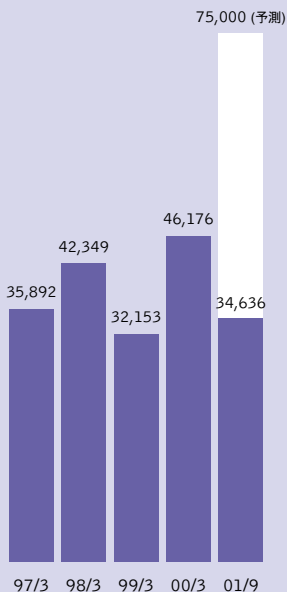


株式会社東京精密

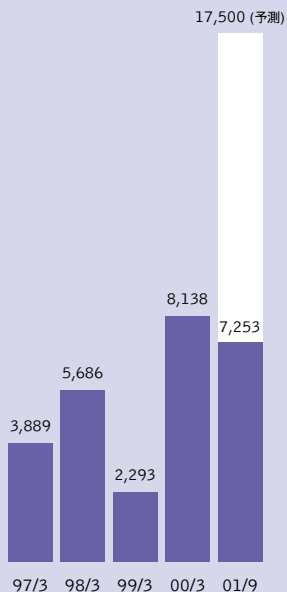
このマークは、1999年12月に制定しました当社のシンボルマークです。このマークは、当社のモットーである「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう。」をシンボライズしたものです。
「高速回転する金色の物体は、世界中から集めたリソース(人、物、金、情報)を表しており、この力を凝縮し、明確なターゲットをもって、最先端の強力な製品を次々と市場に投入していくさまを、物体中央から噴出している高速ジェット流で表しています。」

財務ハイライト

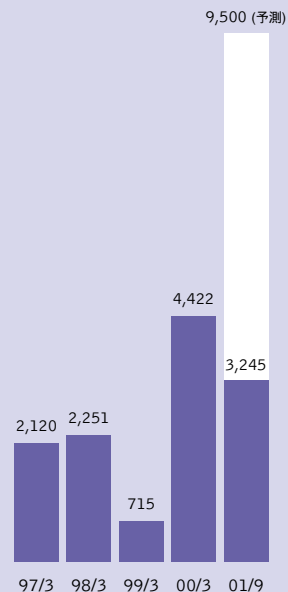
連結売上高(百万円)



連結経常利益(百万円)



連結当期利益(百万円)



単位:百万円

	1997/3	1998/3	1999/3	2000/3	2000/9 (中間期)
連結売上高	35,892	42,349	32,153	46,176	34,636
連結経常利益	3,889	5,686	2,293	8,138	7,253
連結当期(中間)利益	2,120	2,251	715	4,422	3,245
連結総資産	42,257	46,163	41,309	61,007	76,885
連結純資産	18,502	27,604	28,437	33,433	35,649
発行済株式総数(千株)	32,188	36,575	37,004	37,543	37,525
1株当たり当期(中間)利益(円)	65.89	63.87	19.41	118.43	86.46

1株当たり当期(中間)利益は、期中の平均株式数により算出しています。

株主の皆様へ

代表取締役社長

大坪 英夫



東京精密の株式を保有して頂き、有難う存じます。厚く御礼申し上げます。

さて、当社は、株主の皆様が当社株式を保有していただいた目的に沿った経営を目指しております。

当社は、経営指標といたしましては、一株当たりの純利益(EPS)を長期的に増大させていく事を重視しております。会社にとっては、企業価値を長期的に増大させることになりましますし、株主の皆様のご期待に応えることになると考えます。これは当社のモットーであるWIN-WINの関係を株主の皆様と会社との間で作り上げる事につながると確信しております。

当社は、技術指向型の会社です。上記の目的のために当社は次の「製品開発の原則」に沿って技術開発を継続的に行ってまいります。

1. 世界No.1の製品を創る。
マーケットシェアNo.1の商品は
(1)好況時は、利益の極大化を図れる。
(2)不況時は、損失の極小化を図れる。
2. 研究開発投資は自己資金で。
3. 技術参入壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う。
4. 市場規模が停滞縮小傾向にあるが、ユーザーとの関係で、今後もR&D投資が必要な製品は、競合先であってもアライアンスを組み、R&Dコストをシェアする。

この原則を守るためには、各国、各社の持つ異文化を包摂したグローバルかつハイブリットな東京精密の文化風土を醸成しなければなりません。口でいうのは簡単ですが、実行は大変な困難を伴います。株主の皆様にも是非当社の目的にご賛同賜り、今後、当社をこのような会社にしていくために会社経営に格別のご理解とご支援をお願い申し上げます。

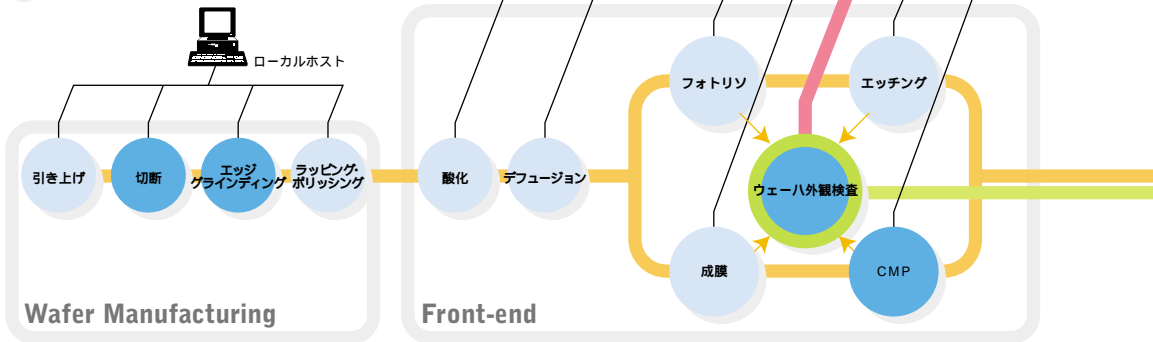
なお、株主の皆様のご支援に報いる為、平成12年3月期には年19円(前中間期9円50銭)の配当とさせていたしましたが、本中間期は5円50銭増配して1株当たり15円とさせていただきます。

代表取締役社長
大坪 英夫

THIS IS TSK

半導体製造工程

● は当社事業領域



東京精密は、半導体製造装置及び精密計測機器メーカーとして、1949年の創業当初から今日に至るまで、100%のUp Time(稼働率)と高精度かつ信頼性の高い装置の提供を心掛け、お客様の生産性向上に寄与できる製品開発とカスタマー・サポートに傾注してまいりました。現在私達は、「世界No.1の商品を創ろう」をモットーに掲げ、これまで培ったコア・テクノロジーに加えて、このモットーに共鳴する会社及び個人と“WIN-WIN”の協力関係を構築し、当社の経営の原則である「製品開発の原則」に基づき、高成長分野における世界No.1商品の開発に邁進しています。

半導体産業は、最先端の製造技術の開発によって高集積化を進め、エレクトロニクスの発展に貢献してきました。特に、近年の半導体業界の発展は目覚ましく、IT時代の本格化に伴い、市場拡大のスピードも一段と加速化され、今後も大きな成長が予測されています。そのような環境下、半導体製造装置メーカーは、これまで猛烈なスピードで進化を遂げる半導体製造技術を支える役割を担い、常に次世代技術に必要な装置の開発に精力的に取り組

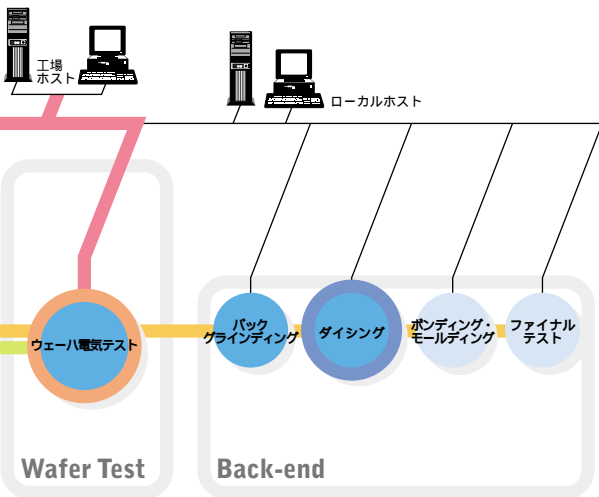


ウェーハフローリングマシン
UF200S

んできましたが、今後益々その役割の重要性は増大すると思われます。昨年発表された半導体技術国際ロードマップには、2014年までのガイドラインが描かれています。現在最先端の量産ラインのデザインルール(微細化)は0.18 μ mで

すが、2014年には一段と微細化が進み、0.035 μ mのデザインルールを採用するというものです。その実現のためには、当然ながら装置技術の画期的なブレーク・スルーが要求される分野があります。レベルの差こそあれ、すべての半導体製造装置に高性能化が求められることは、言うまでもありません。

当社は、これまで半導体製造工程の電気テスト工程(デ



計測機器



パイス特性の一次試験で、良品チップ、不良品チップの選別をする工程)に使用されるウェーハローピングマシンを主力製品とし、後工程でウェーハ

ウェーハダイシングマシン
A-WD-300T

を1つ1つのチップに切断するウェーハダイシングマシン、ウェーハメーカー向けのワイヤーソー、エッジグラインディングマシン等のウェーハ製造装置を製造販売してまいりました。最近では、半導体製造技術のトレンドを鑑み、半導体製造装置の中でも、特に新しい技術開発が高く求められている前工程の製造装置分野にも積極的に経営資源を投入しています。その第一弾の新規参入製品が、ウェーハ外観検査装置、CMP装置及びポリッシュ・グラインダです。ポリッシュ・グラインダは、後工程の装置ですが、今後の市場拡大が期待されている分野です。この他にも、現在開発中の新規参入製品が数種類あります。

当社は、常に次世代を見据え、「Time to Market」を強

く意識し、スピーディな開発を推進し、従来製品は常に最新鋭の製品を、そして技術参入障壁が高い新規参入製品を今後も積極的に市場投入してまいります。それによって、当社は、設備投資動向の変化に伴う業績の変動を比較的軽微に抑え、継続的な成長を遂げられると考えております。



ウェーハ外観検査装置
WIN-WIN 50

営業の概況

1. 当期の概況

当中間期の半導体業界は、パソコンに加え、携帯電話、ネットワーク機器などの通信関連商品、さらにゲーム機器等の消費者関連商品の需要が、前年度を大きく上まわる勢いで推移し、国内外の半導体メーカー各社は、市場拡大に伴う増産に対応するため、設備投資を積極的に実施いたしました。その結果、当社の半導体製造用機器部門の主力製品であるウェーハプロービングマシンおよびウェーハダイシングマシンの売上高は、既往最高を大幅に更新し、当社の半導体製造用機器部門全体の売上高も既往最高となりました。

生産面では、半導体メーカー各社からの受注増に対応する為、リードタイムの短縮と生産の効率化を更に進めると共に、大幅な生産能力の増強を図りました。この結果、世界ナンバーワンのマーケットシェアを誇るウェーハプロービングマシンの月間生産台数は既往最高を更新いたしました。

計測製品部門につきましては、引き続き厳しいビジネス環境ではありましたが、それでも一部に設備投資の回復の兆しが見え始め、着実な営業努力を積み重ね売上増を達成することが出来ました。生産面でもコストダウンを推進して利益率の向上に寄与し、増益を達成しました。

研究開発面では、引き続き、市場ニーズに適合する次世代装置のタイムリーな開発に努めました。その成果として、

ウェーハ外観検査装置「WIN-WIN50」とポリッシュ・グラインダ(ウェーハ裏面研磨装置)「PG200」は、売上を計上するに至りました。また、昨年12月に発表しましたウェーハプロービングマシンの新機種「UF200S」も当期から最先端の生産ライン向けに順調に出荷されています。さらに、ウェーハダイシングマシンにつきましても、前年度後半よりお客様からその機能を高く評価され、ウェーハダイシングマシンの売上に大きく貢献しました。「A-WD-200T」の300mmウェーハ対応機「A-WD-300T」も当期完成し市場の期待を集め、すでにご注文も頂いています。

この結果、当グループの当中間期の連結売上高は346億36百万円、連結経常利益は72億53百万円、連結中間利益は32億45百万円となりました。

部門別の概況は、次の通りです。

〔半導体製造用機器部門〕

半導体市場の活況を反映して、売上高は、274億9百万円と既往最高を更新いたしました。

〔計測機器部門〕

設備投資はやや持ち直し、営業努力も相俟って、売上高は、72億26百万円となりました。

なお、海外売上高は、半導体製造用機器部門の海外比率が伸び、168億44百万円で48.6%となりました。

2. 通期の見通し

2000年度下期の半導体市場は引き続き活況を呈すると見られ、半導体メーカーの設備投資も活発に行われることが予想されます。

このような見通しのもと、当社といたしましては、半導体製造用機器部門の主力製品であるウェーハプロベリングマシンおよびウェーハダイシングマシンの生産の効率化と納期の短縮を推進して、市場のニーズに応じてまいりたいと存じます。また半導体分野の新規参入製品は、今期は上期以上のレベルで売上高に寄与してくる予定で、当社の新たなコアビジネスとするべく、生産、ユーザーサポート、販売体制を一段と強化していく予定でございます。

一方計測部門につきましては、設備投資にやや明るい兆しが見え始めたといっても本格回復にはいまだ時間が必要と思われるので、一層の生産の効率化およびコスト削減の努力をして参る所存です。

以上のような予測のもと、2000年度の連結売上高は、750億円(前年同期比162.4%)、連結経常利益175億円(前年同期比215.0%)、連結当期利益95億円(前年同期比214.8%)となり、前期に引き続き既往最高を更新する予定です。

3. 会社が対処すべき課題

当社は、更なる躍進を目指し、半導体製造用機器部門において成長分野である市場に新たに参入すべく、近年それら新製品の開発に注力してまいりました。それらの新製品のうち「ウェーハ外観検査装置」および「ポリッシュ・グライнда(ウェーハ裏面研磨装置)」は既に本中間期に売上として計上され、今後本格的に業績に寄与する予定です。これら新製品を予定どおり業績に貢献させ、売上の飛躍的な拡大と高収益基盤を確立することを目指し、最大の努力をしてまいります。

次に、活況を呈している半導体市場の顧客ニーズおよび変化に対応できるような生産ラインの構築に引き続き取り組んでいきます。生産能力の増強と共に、リードタイムの短縮が急務であり、現在、社内外のリソースを使って新しいシステム作りを進めております。

また、ITビジネスの飛躍的な成長に伴い、市場の変化には目覚ましいものがあり、経営のスピード化が必須であり、社内インフラの強化も引き続き推進しております。

株主の皆様におかれましては、今後ともよろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。



新本館完成予定図
東京精密は、八王子工場内に新本館を建設中です。新本館は、生産フロアやオフィス、ショールームなどに利用する目的で、2000年5月初旬に着工し、2001年3月末竣工を予定しています。

中間連結貸借対照表

平成12年9月30日現在

単位:千円

科目	資産	科目	負債、少数株主持分及び資本
	金額		金額
流動資産		流動負債	
現金及び預金	7,382,505	支払手形及び買掛金	20,750,419
受取手形及び売掛金	23,441,725	短期借入金	5,350,000
たな卸資産	25,543,889	一年以内に返済する長期借入金	378,514
未収消費税等	436,059	未払法人税等	3,213,118
繰延税金資産	724,334	賞与引当金	942,640
その他の流動資産	422,028	その他の流動負債	2,892,452
貸倒引当金	57,125	(流動負債計)	33,527,145
(流動資産計)	57,893,416		
固定資産		固定負債	
(有形固定資産)		社債	250,000
建物及び構築物	4,338,172	転換社債	54,000
機械装置及び運搬具	2,402,827	長期借入金	3,994,839
工具器具備品	785,782	退職給付引当金	2,929,880
土地	810,594	役員退職慰労引当金	217,873
建設仮勘定	1,074,538	(固定負債計)	7,446,592
(有形固定資産計)	9,411,915		
(無形固定資産)		負債合計	40,973,738
ソフトウェア	4,698,168	少数株主持分	262,528
その他の無形固定資産	138,726	資本	
(無形固定資産計)	4,836,894	資本金	7,013,523
(投資その他の資産)		資本準備金	11,590,704
投資有価証券	2,892,453	連結剰余金	17,458,794
長期貸付金	209,770	その他有価証券評価差額金	248,139
繰延税金資産	1,142,315	為替換算調整勘定	164,101
その他の投資その他の資産	527,366	自己株式	1,367
貸倒引当金	28,862	資本合計	35,649,414
(投資その他の資産計)	4,743,042		
(固定資産計)	18,991,852	負債、少数株主持分及び資本合計	76,885,681
繰延資産			
社債発行差金	412		
(繰延資産計)	412		
資産合計	76,885,681		

中間連結損益計算書

自平成12年4月1日
至平成12年9月30日

単位:千円

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
売上高		34,636,127
売上原価		21,850,140
売上総利益		12,785,987
販売費及び一般管理費		
1. 販売費	4,188,250	
2. 一般管理費	1,436,493	5,624,744
営業利益		7,161,242
営業外収益		
1. 受取利息	24,427	
2. 受取配当金	67,536	
3. 為替差益	112,857	
4. その他の営業外収益	54,433	259,254
営業外費用		
1. 支払利息	66,122	
2. その他の営業外費用	101,345	167,468
経常利益		7,253,028
特別利益		
1. 退職給付信託設定益	1,732,091	
2. その他の特別利益	63,568	1,795,660
特別損失		
1. 退職給付引当金繰入額	2,836,725	
2. ゴルフ会員権評価損	251,536	
3. その他の特別損失	99,163	3,187,425
税金等調整前当期純利益		5,861,262
法人税、住民税及び事業税	3,176,216	
法人税等調整額	582,286	2,593,930
少数株主利益		21,662
連結中間利益		3,245,670

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自平成12年4月1日
至平成12年9月30日

単位:千円

科目	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期利益	5,861,262
減価償却費	744,872
有形固定資産除却損	99,876
その他有価証券売却益	23,320
ゴルフ会員権評価損	251,536
貸倒引当金の増減額	29,367
退職給付引当金増減額	49,669
賞与引当金の増減額	204,415
受取利息及び受取配当金	91,963
支払利息	66,078
売上債権の増減額	7,127,577
たな卸資産の増減額	7,996,522
仕入債務の増減額	7,551,698
取締役賞与の支払額	64,890
その他主たる営業活動	1,625,555
小計	1,121,325
利息及び配当金受取額	92,012
利息の支払額	66,078
法人税等の支払額	3,537,258
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,389,998

科目	金額
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	211,835
定期預金の払出による収入	170,000
有形固定資産の取得	1,329,091
無形固定資産の取得	10,440
有形固定資産の売却	22,672
その他有価証券の取得	272,157
関係会社有価証券の取得	200,000
その他有価証券の売却による収入	41,307
短期貸付金の回収	1,531
長期貸付金の回収	16,244
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,771,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	5,000,000
短期借入金の返済	39,000
長期借入れによる収入	1,000,000
長期借入金の返済	258,637
自己株式消却による支出	202,029
配当金の支払	356,661
その他財務活動フロー	2,014
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,145,686
現金及び現金同等物に係る換算差額	45,364
現金及び現金同等物の増加額	938,554
現金及び現金同等物の期首残高	6,232,115
現金及び現金同等物期末残高	7,170,669

中間連結財務諸表作成の基本となる事項

1. 連結の範囲

- (1) 連結子会社 7社
- (2) 非連結子会社 4社

2. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

- a 子会社株式 移動平均法による原価法
- b その他有価証券

時価のあるもの 中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

- (ロ) たな卸資産 商品・製品・材料・及び貯蔵品は先入先出法による原価法、仕掛品は個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- (イ) 有形固定資産 定率法
- (ロ) 無形固定資産 定額法、なお自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。

(3) 重要な引当金の計上基準

- (イ) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- (ロ) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上している。
- (ハ) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上している。
- (ニ) 役員退職慰労引当金 役員の退任時に支出が予測される役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間期末支払見込額を計上している。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

中間貸借対照表(単独決算)

平成12年9月30日現在

単位:千円

科 目	資産の部		科 目	負債及び資本の部	
	金 額			金 額	
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	52,858,013		流動負債	30,859,022	
現金及び預金	5,327,296		支払手形	14,019,752	
受取手形	2,208,527		買掛金	5,978,225	
売掛金	21,032,446		短期借入金	5,000,000	
たな卸資産	21,402,002		未払金	1,150,426	
未収消費税等	405,416		未払法人税等	2,573,987	
繰延税金資産	583,056		賞与引当金	696,300	
その他	1,905,596		その他	1,440,330	
貸倒引当金	6,328				
固定資産	18,818,809		固定負債	6,384,004	
(有形固定資産)	(6,364,588)		社債	3,800,000	
建物及び構築物	2,436,750		転換社債	54,000	
機械装置	1,738,316		退職給付引当金	2,361,503	
土地	433,706		役員退職慰労引当金	168,501	
その他	688,707		負債合計	37,243,027	
建設仮勘定	1,067,109				
(無形固定資産)	(4,734,111)		(資本の部)		
ソフトウェア	4,691,316		資本金	7,013,523	
その他	42,794		法定準備金	12,202,272	
(投資等)	(7,720,108)		資本準備金	11,590,704	
投資有価証券	2,620,402		利益準備金	611,567	
子会社株式	3,388,803		剰余金	15,494,608	
長期貸付金	205,000		別途積立金	5,000,000	
繰延税金資産	1,017,432		中間未処分利益	10,494,608	
その他	508,537		(うち中間利益)	(3,010,368)	
貸倒引当金	20,066		その他有価証券評価差額金	245,276	
繰延資産	31,333		資本合計	34,465,128	
社債発行差金	31,333				
資産合計	71,708,155		負債及び資本合計	71,708,155	

(注) 1. 子会社に対する短期金銭債権
2. 子会社に対する短期金銭債務
3. 子会社に対する長期金銭債権

5,093,542千円
2,908,845千円
91,725千円

4. 子会社に対する長期金銭債務
5. 有形固定資産の減価償却累計額
6. 受取手形割引高

3,800,000千円
6,566,385千円
3,011,166千円

中間損益計算書(単独決算)

自平成12年4月1日
至平成12年9月30日

単位:千円

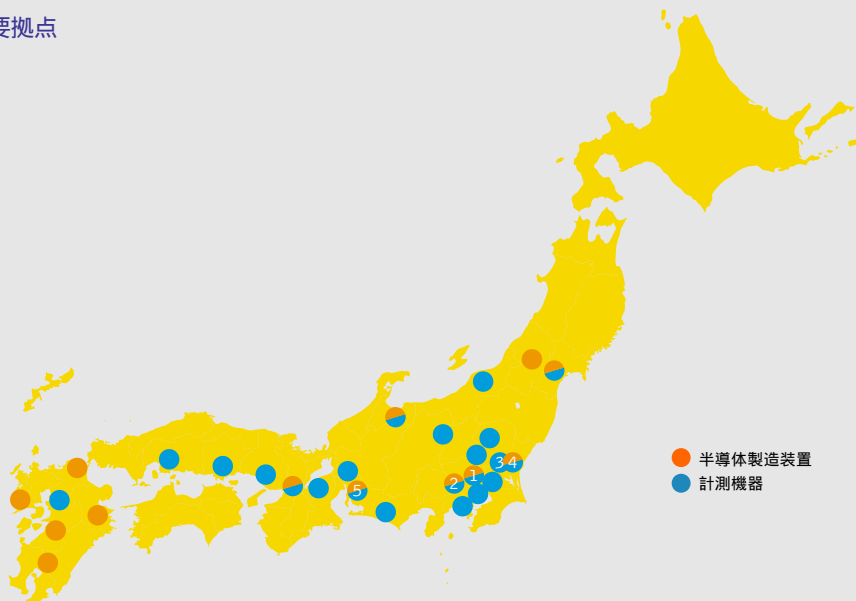
科 目		金 額		
		内 訳	合 計	
経常 損益 の部	営業 損益 の部	営業収益		30,882,374
		売上高	30,882,374	
		営業費用		24,898,209
		売上原価	20,660,585	
		販売費及び一般管理費	4,237,623	
	営業利益		5,984,164	
	営業外 損益 の部	営業外収益		417,944
		受取利息及び配当金	308,515	
		その他の営業外収益	109,429	
		営業外費用		105,309
支払利息		67,299		
その他の営業外費用	38,009			
経常利益			6,296,800	
特別 損益 の部	特別利益		1,838,171	
	退職給付信託設定益	1,732,091		
	その他の特別利益	106,080		
	特別損失		2,979,779	
	退職給付引当金繰入額	2,629,078		
その他の特別損失	350,700			
税引前中間利益			5,155,192	
法人税、住民税及び事業税		2,620,168		
法人税等調整額		475,344	2,144,823	
中間利益			3,010,368	
前期繰越利益			7,686,268	
自己株式消却額			202,029	
中間未処分利益			10,494,608	

(注)子会社との取引高

(1)売上高	4,736,835千円
(2)仕入高	5,499,530千円
(3)営業取引以外の取引高	51,933千円

国内外拠点

国内主要拠点



本社



八王子工場
株式会社エスケー・マイクロテクノロジー



土浦工場

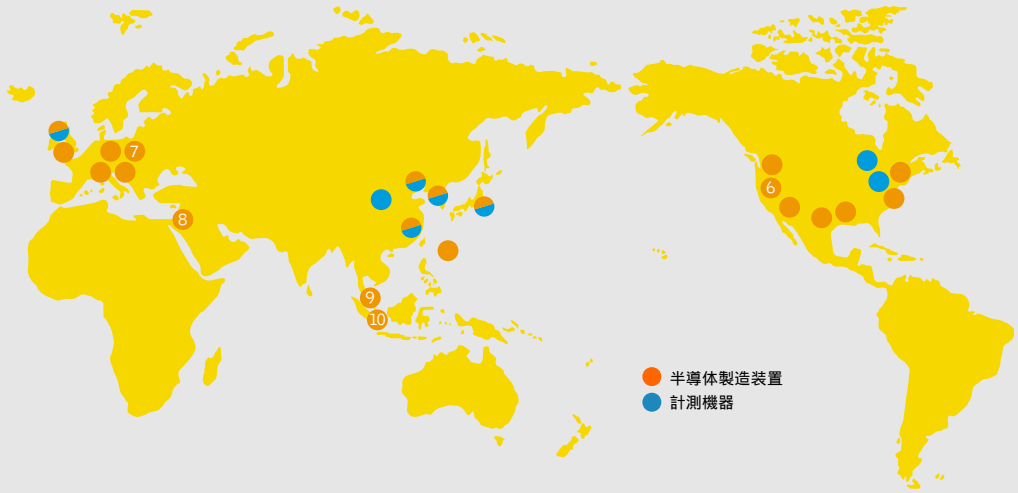


株式会社エスケー・マイクロテクノロジー
株東精エンジニアリング
本社・工場



株東精エンジニアリング
名古屋工場

海外拠点



6 TSK America, Inc.



7 Tokyo Seimitsu Europe GmbH



8 Tokyo Seimitsu (Israel) Ltd.



9 Tokyo Seimitsu (Malaysia) Sdn. Bhd.

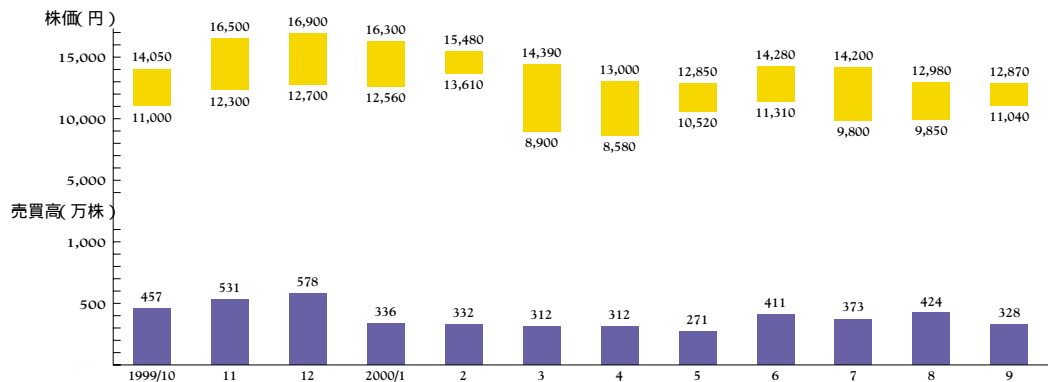


10 Tokyo Seimitsu (Singapore) Pte. Ltd.

沿革

1949	東京精密工具(株)設立、東島好蔵社長	1994	八王子土浦両工場一括でISO 9001の認証取得
1950	諫早良三社長就任		計量法トレーサビリティ制度に基づく長さ測定用レーザーの校正認定事業者として八王子工場が認定取得
1951	メカニカルゲージを応用した各種測定器の製作販売開始		北京駐在事務所開設
1952	高圧流量式空気マイクロメータのわが国初の工業化に成功		マレーシアに現地法人 Tokyo Seimitsu (Malaysia) Sdn. Bhd. 設立
1955	高城誠社長就任	1995	計量法トレーサビリティ制度に基づく端度器(ブロックゲージ)の校正認定事業者として土浦工場が認定取得
1957	差動変圧器式電気マイクロメータのわが国初の工業化に成功 第一精機(株)設立		中国三門峡中原量儀股份有限公司と合併会社三門峡中原精密有限责任公司を設立
1958	ゲルマニウムベレット厚さ自動選別機の開発		米国に現地法人 TSK America, Inc. および TSK Manufacturing Company 設立
1962	株式会社東京精密に社名変更 東京証券取引所市場第二部に株式上場 表面粗さ測定機の開発		ドイツ、カールツァイス社と精密測定機器分野で前面提携
1963	ウェーハスライシングマシンの開発 八王子工場第一期工事完成		米国キューリックアンドソファインダグストリーズ社とダイシングマシンの販売ライセンス契約を締結
1964	ウェーハプロービングマシンの開発 中国と電気空気マイクロメータのプラント技術輸出契約締結	1996	半導体製造装置サプライヤー顧客満足度調査(VLSIリサーチ社調べ)で10 BEST賞を受賞 台湾新竹市にテクニカルセンター開設 Tokyo Seimitsu (Israel) Ltd. 設立
1967	真円度測定機の開発	1997	(株)東精エンジニアリング、名古屋に新工場完成 10 BEST賞を2年連続受賞 Tokyo Seimitsu (Singapore) Pte. Ltd. 設立
1969	(株)東精エンジニアリング設立 土浦工場第一期工事完成 三次元座標測定機のわが国初の開発		米国現地法人を TSK America, Inc. に統合
1970	ウェーハダイシングマシンの開発	1998	八王子土浦工場一括でISO 14001の認証取得 10 BEST賞を3年連続受賞
1980	三浦明社長就任	1999	(株)東精エンジニアリング、土浦に新本社及び工場完成 (株)ティーエスケイファイナンス設立 10 BEST賞を4年連続受賞
1985	ソフトウェア開発専門会社(株)トーセシステムズを(株)シーイーシーと共同で設立		(株)マイクロテクノロジーをウェーハ外観検査装置の開発生産販売サポート会社とするため、(株)ティーエスケイマイクロテクノロジーに組織変更
1986	東京証券取引所市場第一部に株式上場 今澤五郎社長就任		スイス、HCT社とワイヤソー及びその関連装置について業務提携
1987	技術研究所設立		新しいシンボルマークをセミコンジャパン '99にて発表
1988	軽部昭三社長就任	2000	ポータブル3Dビジョンシステムにて、イスラエルのコグニテンス社と日本国内における独占販売契約を締結 八王子工場新本館(11階建)建設着工
1989	ドイツに現地法人 Tokyo Seimitsu Europe GmbH 設立 米国に現地法人 Tokyo Seimitsu America, Inc. 設立		10 BEST賞を5年連続受賞
1992	大坪英夫社長就任 米国シリコンテクノロジー(STC)社を買収 韓国に現地法人(株)TSKサービスセンター開設 第一精機(株)を(株)マイクロテクノロジーに社名変更		

株価の推移 (平成12年9月30日現在)



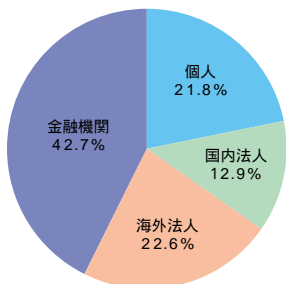
年・月	1999.10	11	12	2000.1	2	3	4	5	6	7	8	9
高値(円)	14,050	16,500	16,900	16,300	15,480	14,390	13,000	12,850	14,280	14,200	12,980	12,870
安値(円)	11,000	12,300	12,700	12,560	13,610	8,900	8,580	10,520	11,310	9,800	9,850	11,040
売買高(万株)	457	531	578	336	332	312	312	271	411	373	424	328

株式の状況 (平成12年9月30日現在)

会社が発行する株式の総数	110,754,100株
発行済株式の総数	37,525,224株
当期中の増減	
転換社債の転換による新株発行	2,190株
利益による自己株式の消却	20,000株

株主数 17,274名

所有者別状況



大株主

株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
東洋信託銀行株式会社	2,052	5.5
野村信託銀行株式会社(信託口)	1,752	4.7
株式会社富士銀行	1,608	4.3
三菱信託銀行(信託口)	1,591	4.2
ザチースマンハッタンバンクエヌエイロンドン	1,341	3.6
日本精工株式会社	1,313	3.5
三井生命保険相互会社	1,151	3.1
安田火災海上保険株式会社	1,082	2.9
財団法人精密測定技術振興財団	1,058	2.8
高城ヒデ子	815	2.2

東洋信託銀行株式会社の持株数には、信託勘定分534千株が含まれております。
三井生命保険相互会社の持株数には、特別勘定分51千株が含まれております。

会社の概況 (平成12年9月30日現在)

商号	株式会社 東京精密 (TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)	事業所	本社 技術研究所 工場	東京都三鷹市 東京都八王子市 八王子(東京都八王子市) 土浦(茨城県土浦市)
設立	昭和24年3月28日	営業所	東北(宮城県仙台市) 山形(山形県山形市) 茨城(茨城県土浦市) 宇都宮(栃木県宇都宮市) 埼玉(埼玉県大宮市) 城東(東京都足立区) 東京(東京都三鷹市) 西東京(東京都八王子市) 川崎(神奈川県川崎市) 新潟(新潟県分水町) 厚木(神奈川県厚木市) 北陸(富山県富山市)	長野(長野県岡谷市) 浜松(静岡県浜松市) 名古屋(愛知県三好町) 小牧(愛知県西春町) 京滋(滋賀県守山市) 大阪(大阪府吹田市) 加古川(兵庫県加古川市) 岡山(岡山県岡山市) 広島(広島県広島市) 九州(福岡県久留米市) 九州(大分県大分市)
資本金	7,013,523,351円(2000.9.30現在)			
証券取引所	東京証券取引所 市場第一部			
役員(平成12年9月30日現在)	代表取締役社長 大坪 英夫 代表取締役常務取締役 鴻田 道明 代表取締役常務取締役 川原 栄次 代表取締役常務取締役 鈴木 貞勝 代表取締役常務取締役 薦 清昭 取締役 高城 英明 取締役 伊勢 徹 取締役 森内 信行 取締役 西嶋 尚生 取締役 林 和博 監査役(常勤) 輕部 昭三郎 監査役(常勤) 柳沢 忠 監査役 坂田 耕四郎 監査役 野口 光			
従業員数	668名(2000.9.30現在)	国内子会社	株式会社 東精エンジニアリング 株式会社 ティーエスケイ・マイクロテクノロジー 株式会社 トーセシステムズ 株式会社 東精クリエイト 株式会社 ティーエスケイ・ファイナンス	
主要取引銀行	富士銀行 本店 東洋信託銀行 日本橋支店 さくら銀行 吉祥寺支店 あさひ銀行 三鷹支店 東京三菱銀行 新宿中央支店 常陽銀行 土浦支店 関東銀行 本店	海外子会社	TSK America, Inc. Tokyo Seimitsu Europe GmbH Tokyo Seimitsu (Malaysia) Sdn. Bhd. Tokyo Seimitsu (Israel) Ltd. Tokyo Seimitsu (Singapore) Pte. Ltd.	
		海外関連会社	三門峡中原精密有限责任公司	

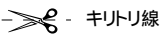
株主メモ

決算期	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月中基準日毎年3月31日 その他必要あるときは、あらかじめ基準日を公告いたします。
名義書換代理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 東洋信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒136-0074 東京都江東区東砂七丁目10番11号 東洋信託銀行株式会社 証券代行部 電話(03)5683-5111(代表)
同取次所	東洋信託銀行株式会社
株式取扱手数料	名義書換 無料 新株券交付 無料
公告掲載新聞	東京都において発行される日本経済新聞

株主の皆様へアンケートのお願い

弊社では、株主の皆様の声を経営に反映させるべく、アンケートを実施させていただきます。お手数ではございますが、アンケートの質問事項をお読みいただき、回答をご記入の上、ご投函下さい。

皆様のご協力をお願い申し上げます。



株主の皆様へアンケートのお願い

1. 弊社の株式をご購入された理由は何でしょうか？

- 1) 将来性 2) 収益性 3) 経営理念 4) 事業内容 5) 証券会社に勤められて
6) その他()

2. 今後の弊社株式についてどのような方針をお持ちですか？

- 1) 買い増し 2) 長期保有 3) 売却

また、上記方針を決定するための判断材料は何ですか？

- 1) 株価 2) 配当 3) 将来計画 4) 業績 5) その他()

3. 今回の事業報告書で興味を持たれた記事はどれでしょうか？

- 1) 社長挨拶 2) THIS IS TSK 3) 営業の概況 4) 財務データ
5) その他()

4. 今後事業報告書で取り上げて欲しいテーマをお聞かせ下さい。

()

5. 株式投資歴をお聞かせ下さい。

- 1) 3年未満 2) 3年以上10年未満 3) 10年以上20年未満 4) 20年以上

6. 所有株式数をお聞かせ下さい。

- 1) 100株 2) 200株以上 3) 500株以上 4) 1,000株以上 5) 5,000株以上

7. 弊社株式保有歴をお聞かせ下さい。

- 1) 1年未満 2) 1年以上 3) 3年以上 4) その他()

8. その他、弊社に対するご意見・ご希望があればお願いいたします。

()

ご住所

お名前

男性・女性

年齢

✂ キリトリ線



郵便はがき

料金受取人払

三鷹局承認

775

1 8 1 8 7 9 0

差出有効期限
平成13年3月
31日まで

東京都三鷹市下連雀9-7-1

株式会社 東京精密
業務部 総務グループ 宛

